

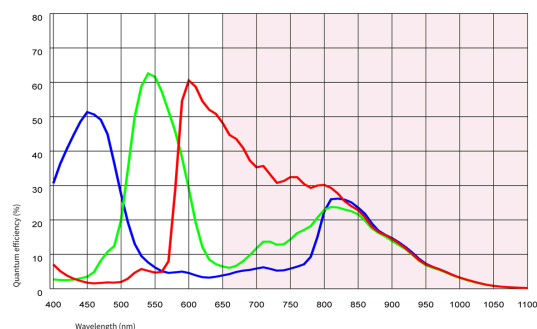
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	2 MP
有効画素数	2.30 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	1920 x 1200 ピクセル
アスペクト比	16:10
ADC	10 bit
色深度 (カメラ)	10 bit
光学センサークラス	1/2.6"
撮像面積	5.760 mm x 3.600 mm
光学センサーの対角	6.79 mm 1/2.6"
画素サイズ	3 µm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Onsemi
センサーモデル	AR0234CSC00SUKA0
ゲイン (マスター/RGB)	9.5x/15.1x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	48 / 12
AOI 画像の高さ、ステップ幅	4 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	4 / 2
ビンニング水平	増加したフレームレート
ビンニング垂直	増加したフレームレート
ビンニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ビンニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング) 水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング) 垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング) 手法	M/C 自動
デシメーション(サブサンプリング) 係数	4x4



モデル

フレームレートフリーランモード	101 fps
フレームレートトリガー（連続）	100 fps
フレームレートトリガー（最大）	100 fps
露出時間（最小～最大）	0.012 ms - 446 ms
消費電力	0.5 W - 1 W
画像メモリ	-

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F
動作時の許容周囲温度	0 ° C - ° C / 32 ° F - 32 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	USB 3.0 micro-B、ねじ止め式
I/O コネクター	Wuerth 製 8 ピンコネクター
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクター

1	電圧出力 3.3 V
2	接地 (GND)
3	オプトカプラなしのフラッシュ出力 - Line 1
4	オプトカプラなしのトリガー入力 - Line 0
5	汎用入出力 (GPIO) 1 - Line 2
6	汎用入出力 (GPIO) 2 - Line 3
7	接地 (GND)
8	USB 給電: 5 V、最大 400 mA

Pin 1



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP30
外形寸法	29.0 mm x 29.0 mm x 17.0 mm
重量	61 g
ハウジング素材	亜鉛、ニッケルメッキ

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	-
Line scan	-

フラッシュ

Flashing	✓
PWM flashing	-

技術は変更されることがあります (2026-07-13)

ページ 2 の 3

www.ids-imaging.jp

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

U3-3560XCP-C-HQ Rev. 1.2 (1008717)

画像調整

Auto exposure	-
Auto gain	-
Auto whitebalance	-
Color correction	-
Gamma	-
LUT	-
Mirror/flip	X/Y

統合画像処理

Pixel formats	BayerGR8 BayerGR10g40IDS
Region of interest	✓
Decimation (FPGA)	-
Decimation (Sensor)	
Binning (FPGA)	-
Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.

その他

Chunks	-
Sequencer	-
Events	-
Firmware update	✓
1st supported firmware version	3.20